

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TACKY FLUX BTFO-81-1

Tacky Flux ROLO (WEE/RoHS conformant)

Clasificación 1.2.3.1 acc. UNE-EN ISO 9454:2016 // ROLO acc. DIN EN 61190-1-1

INFORMACIÓN TÉCNICA

Flux	No clean tacky flux (ROLO) – Sin Haluros
Apariencia	Amarillento /Gel Blanco
Olor	Leve
Densidad a 20°C (gcm⁻³)	0.9-1.0
Activadores/resina	Modificada con solución de ácidos carboxílicos
Caducidad	12 meses
Packaging	10 ml – Jeringa (Pack 40 unidades)

INFORMACIÓN GENERAL:

El Flux "gel" Tacky Flux BTFO-81-1, ha sido especialmente desarrollado para soldadura de reparación, "Rework", etc. Es adecuado para el desestañado y estañado. El Tacky Flux BTFO-81-1 se caracteriza por propiedades mejoradas de humectación y esparcimiento. La aplicación se realiza mediante una jeringa dosificadora con punta metálica. Esto permite una dosificación y un posicionamiento precisos del fundente. El procesamiento del fundente pegajoso de soldadura se puede realizar con la ayuda de aire caliente o soldadores.

El residuo es transparente, no corrosivo y no conductor, por lo que no es necesario eliminarlo, aunque si se desea, se puede limpiar fácilmente con isopropanol, disolvente o sistemas semiacuosos. El Tacky Flux BTFO-81-1 es compatible con aplicaciones con y sin plomo.

VALORES AÑADIDOS:

- Buenas propiedades de soldadura (capilaridad, humectación).
- Dosificación exacta mediante cánula y aguja metálica.
- VOC-free.
- Residuos transparentes, no conductores y no corrosivos.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULADO

- Proteger de la luz solar.
- Evitar almacenar en áreas con altas temperaturas.
- Una vez usado, cerrar con el tapón. Limpiar boquilla difusora.



RECOMENDACIONES ADICIONALES

Las agujas dosificadoras necesitan cuidados, en particular con interrupciones de funcionamiento más prolongadas. Los geles podrían secarse y las agujas comenzarían a bloquearse. Esto se puede evitar retirando la aguja y limpiar con alcohol común o isopropanol. Esto no afectará los resultados de la soldadura, ya que los restos del alcohol común o isopropanol, evaporarán durante el proceso de soldadura con el sistema disolvente del gel fundente.

Revision: 13/01/2021